



PBN及CVD
技术领导者



PBN

事业部

PBN简介

热解氮化硼 (PBN) 属于六方晶系, 为先进陶瓷材料, 纯度可以达到 99.999%, 耐酸碱, 抗氧化, 导热性好, 致密, 可加工。它在高温、高真空条件下, 由氨和硼的卤化物进行化学气相沉积 (CVD) 而成, 既可以制备PBN板材, 也可以直接制备坩埚, 舟, 涂层等PBN最终产品。

主要特点

- ▶ 无毒、无味
- ▶ 纯度高, 达到99.999%以上
- ▶ 室温下与酸、碱、盐及有机试剂不反应, 在熔融的盐、碱液中略腐蚀, 但能抗高温下各种酸的腐蚀
- ▶ 与大多数熔融金属、半导体及其化合物不反应
- ▶ 在1000°C以下, 抗氧化性能良好
- ▶ 抗热震性能良好, 2000°C投入水中未见裂纹
- ▶ 使用温度高, 无升华点, 在3000°C以上直接分解为B和N
- ▶ 电阻高, 电绝缘性能好
- ▶ 表面光滑, 无气孔, 与大多数半导体熔体不湿润



产品应用

OLED 蒸发单元	MOCVD 加热器	卫星通讯微波管
半导体单晶生长(VGF、LEC) 坩埚	多晶合成舟	PBN涂层载盘
分子束外延(MBE) 蒸发坩埚	PBN红外窗口	高温、高真空设备绝缘板

主要性能参数

主要参数	数值	单位
密度	1.95-2.22	g/cm ³
抗张强度	112	MPa
抗弯强度	173	MPa
耐压强度	154	MPa
杨式模量	18	GPa
热导率	"a" 60 "c" 2	W/m°C
比热容	0.90 (RT)	J/g · °C
电阻率	2×10^{15}	Ω.cm
介电强度	$>2 \times 10^5$	D.C. volts/mm
损耗角正切	1.1×10^{-4} (@20GHz)	
介电常数	"a" 5.20	
金属杂质含量	<10	ppm
放气率	极低	

晶体生长应用

—VGF坩埚, LEC坩埚, PBN舟

化合物半导体单晶(如GaAs, InP, Ge等)生长的VGF、VB、HB、LEC工艺中, PBN坩埚为该工艺最理想的生长容器, 同时PBN舟也广泛用于其材料的多晶合成工艺中。

产品特点

- ▶ 纯度>99.999%
- ▶ 与熔融金属不润湿
- ▶ 热导率可控, 有效提高成晶率
- ▶ 优异的抗热震性
- ▶ 易清洗, 可重复使用
- ▶ 化学惰性, 在高温下与酸、碱不发生化学反应

规格参数

VGF坩埚

- ▶ 外径:2",3",4",5",6",8",10",12"
- ▶ 纯度:>99.999%
- ▶ 高度:100mm-500mm
- ▶ 厚度:0.4mm-2.0mm



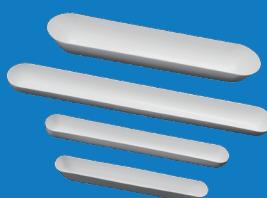
LEC坩埚

- ▶ 外径:2",3",4",5",6",8",14",20"
- ▶ 纯度:>99.999%
- ▶ 高度:100mm-500mm
- ▶ 厚度:0.4mm-2.0mm



PBN舟

- ▶ 外径:2",3",4"
- ▶ 纯度:>99.999%
- ▶ 长度:100mm-500mm
- ▶ 厚度:0.8mm-1.2mm



*更多规格, 欢迎咨询定制。

*更多规格, 欢迎咨询定制。

*更多规格, 欢迎咨询定制。

OLED & MBE & CIGS 应用

—PBN蒸发源坩埚

在OLED、MBE及CIGS的蒸发源中，
PBN坩埚作为理想的蒸镀材料容器得到广泛应用。

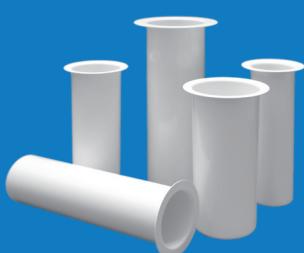
产品特点

- ▶ 纯度>99.999%
- ▶ 高温下放气率极低
- ▶ 厚度均匀, 加热一致性好
- ▶ 优异的热导率和抗热震性
- ▶ 易清洗和反复使用
- ▶ 强度高, 高温下不易变形
- ▶ 化学惰性, 在高温下与酸、碱不发生化学反应

规格参数

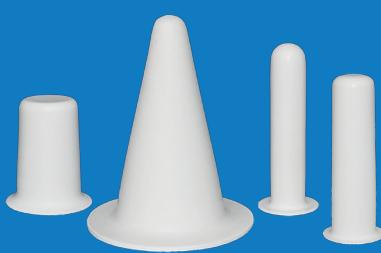
OLED坩埚

- ▶ 外径:50mm-150mm
- ▶ 厚度:0.7mm-1.2mm
- ▶ 高度:100mm-400mm
- ▶ 纯度:>99.999%
- ▶ 容量:150cc, 350cc, 550cc, 700cc, 800cc, 1000cc, 2000cc



MBE坩埚

- ▶ 外径:25mm-260mm
- ▶ 厚度:0.6mm-1.5mm
- ▶ 高度:20mm-700mm
- ▶ 纯度:>99.999%
- ▶ 形状:锥形,圆柱形,及各类异形坩埚。
- ▶ 容量:5cc, 20cc, 60cc, 125cc, 700cc, 1700cc, 3700cc等



CIGS 坩埚

- ▶ 外径:Max 260mm
- ▶ 纯度:>99.999%
- ▶ 高度:Max 500mm
- ▶ 厚度:0.4-2.0mm



*更多规格,欢迎咨询定制。

*更多规格,欢迎咨询定制。

*更多规格,欢迎咨询定制。

高温真空应用

——点源导流环, MOCVD绝缘板, PBN夹持杆

在航空航天、半导体制造、晶片外延等诸多领域, 需要用到大量纯度高, 绝缘性好, 耐高温的PBN部件来匹配并适应其复杂的工作环境, 博宇强大的技术实力, 可以为客户提供先进的解决方案。

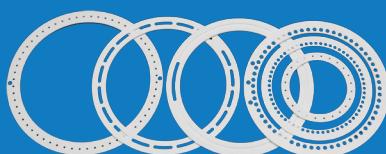
产品特点

- ▶ 纯度>99.999%
- ▶ 厚度均匀性好
- ▶ 高电阻率和绝缘性
- ▶ 高温下放气率极低
- ▶ 强度高, 高温下不易变形
- ▶ 化学惰性, 在高温下与酸、碱不发生化学反应
- ▶ 涂层与基体结合紧密, 不易脱落
- ▶ 致密性好, 可以有效防止石墨挥发

规格参数

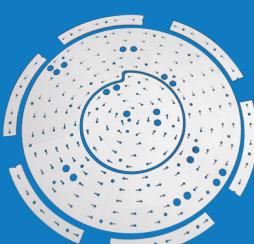
点源导流环

- ▶ 外径:5mm-300mm
- ▶ 厚度:Max 5mm
- ▶ 纯度:>99.999%
- ▶ 密度:2.10g/cm³- 2.20g/cm³



MOCVD绝缘板

- ▶ 圆片:Max ϕ 500mm
- ▶ 方片:Max 400x400mm
- ▶ 厚度:Max 5mm
- ▶ 密度:Max 2.22g/cm³



PBN夹持杆

- ▶ 热导率:112W/m°C
- ▶ 介电强度:>DC2.4X10⁵ V/mm
- ▶ 介电常数:5.27
- ▶ 损耗角正切:1.1*10⁻⁴ (@20GHz)



*更多规格, 欢迎咨询定制。

*更多规格, 欢迎咨询定制。

*更多规格, 欢迎咨询定制。

PBN异形容器

—方舟,螺纹坩埚,喷嘴

PBN优异的性能使其有很多潜在的应用场景,博宇可根据客户的实际需要,设计不同形状、不同规格的薄壁坩埚及器件,如方形坩埚、螺纹坩埚以及异形喷嘴等,满足不同应用场景对PBN容器的需求。

产品特点

- ▶ 纯度>99.999%
- ▶ 厚度均匀性好
- ▶ 高电阻率和绝缘性
- ▶ 高温下放气率极低
- ▶ 强度高,高温下不易变形
- ▶ 化学惰性,在高温下与酸、碱不发生化学反应

规格参数

PBN方舟

- ▶ 长度:Max 500mm
- ▶ 宽度:Max 150mm
- ▶ 高度:Max 150mm
- ▶ 厚度:0.4-2.0mm



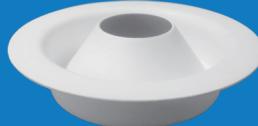
PBN螺纹坩埚

- ▶ 外径:Max 260mm
- ▶ 纯度:>99.999%
- ▶ 高度:Max 500mm
- ▶ 厚度:0.4-2.0 mm



PBN喷嘴

- ▶ 外径:Max 150mm
- ▶ 纯度:>99.999%
- ▶ 厚度:0.4-1.0mm



*更多规格,欢迎咨询定制。

*更多规格,欢迎咨询定制。

*更多规格,欢迎咨询定制。

PBN涂层应用

——涂层加热器, 涂层坩埚, 涂层舟

PBN涂层可以保护石墨器件在高温下免受腐蚀性气体侵蚀, 如熔融金属、酸、氨气等, 防止石墨器件在高温高真空环境下的杂质挥发, 常用于加热器、坩埚、舟等石墨件的涂层保护。

产品特点

- ▶ 纯度>99.999%
- ▶ 高电阻率和绝缘性
- ▶ 高温下放气率极低
- ▶ 化学惰性, 在高温下与酸、碱不发生化学反应
- ▶ 涂层与基体结合紧密, 不易脱落
- ▶ 致密性好, 可以有效防止石墨挥发

规格参数

涂层加热器

- ▶ 直径:Max ϕ 300mm
- ▶ 基体:石墨材料
- ▶ 高度:Max 400mm
- ▶ 厚度:Max 300 μ m(涂层)



涂层坩埚

- ▶ 直径:Max ϕ 300mm
- ▶ 基体:石墨材料
- ▶ 高度:Max 400mm
- ▶ 厚度:Max 300 μ m(涂层)



涂层舟

- ▶ 长度:Max 500mm
- ▶ 基体:石墨材料
- ▶ 厚度:Max 1mm(涂层)



*更多规格, 欢迎咨询定制。

*更多规格, 欢迎咨询定制。

*更多规格, 欢迎咨询定制。



PG 事业部

PG材料简介

热解石墨 (PG) 是一种高纯烃类气体在一定炉压下, 在1800°C -2000°C下, 采用化学气相沉积法 (CVD) 制备的具有较高晶向的高密度、高纯度的新型碳素材料; 热解石墨具有独特的热、电和化学特性, 能够在1800°C下保持 10^{-7} mmHg的真空间度; 并且其机械性能和电性能远优于传统石墨材料, 可制作成板材、独立形状的坩埚、舟、管, 也可以在石墨和其他基材上沉积不渗透涂层。

主要特点

- ▶ 无毒、无味
- ▶ 高纯(>99.999%)
- ▶ 耐高温,强度随使用温度升高而升高
- ▶ 热导率高,热膨胀系数小,抗热震性能好
- ▶ 化学稳定好,耐酸、碱、盐及有机溶剂,与熔融金属不浸润、不反应
- ▶ 放气率极低
- ▶ 表面致密,无气孔,易机械加工



产品应用

散热片	电子束熔炼(EBM)坩埚	元素分析
火箭喷管喉衬	离子束注入组件	MOCVD晶圆基座
溅射靶	等离子刻蚀组件	加热元件

主要性能参数

主要参数	数值	单位	方向
密度	2.15-2.22	g/cm ³	-
电阻率	2×10^{-4}	$\Omega \cdot \text{cm}$	ab
	0.6	$\Omega \cdot \text{cm}$	c
热导率	382	W/m°C	ab
	2.8	W/m°C	c
热膨胀系数(20°C)	0.5	$\mu\text{m}/\text{m°C}$	ab
升华温度	3650	°C	-
拉伸强度	80	MPa	ab
	130	MPa	ab
抗弯强度	116	MPa	c
抗压强度	80	MPa	ab
杨氏模量	20	GPa	ab

热解石墨(PG)坩埚及板材

—PG坩埚, PG板材, PG涂层

PG材料具有耐高温, 放气率低, 与熔融金属不浸润、不反应, 以及热导率高等优异特点, 广泛的应用于元素分析、金属熔炼、材料蒸镀等领域。

产品特点

- ▶ 纯度高达99.999%以上、气密性好
- ▶ 耐高温、强度随使用温度的升高而增加
- ▶ 导热率高, 热膨胀系数小, 有良好的抗热震性能
- ▶ 易清洗, 可重复使用
- ▶ 化学稳定性好, 耐酸、碱、盐及有机试剂腐蚀
- ▶ 与熔融金属、炉渣和其他腐蚀性介质均不反应

规格参数

PG坩埚

- ▶ 外径:15mm-200mm
- ▶ 厚度:Max 3mm
- ▶ 高度:15mm-400mm
- ▶ 纯度:>99.999%



PG板材

- ▶ 圆片:Max ϕ 300mm
- ▶ 方片:Max 210x210mm
- ▶ 厚度:Max 3mm
- ▶ 密度:Max 2.22g/cm³



PG涂层

- ▶ 涂层尺寸:Max ϕ 800mm
- ▶ 涂层基体:石墨 or PBN
- ▶ 涂层厚度:Max 70um
- ▶ 涂层纯度:>99.999%



*更多规格, 欢迎咨询定制。

*更多规格, 欢迎咨询定制。

*更多规格, 欢迎咨询定制。

热解石墨制品

—PG管, PG栅极

PG材料具有耐高温, 放气率低, 与熔融金属不浸润、不反应, 以及热导率高等优异特点, 广泛的应用于元素分析、金属熔炼、材料蒸镀等领域。

PG管



PG栅极



复合加热器

—PBN/PG/PBN 加热器

PBN/PG/PBN复合加热器采用PBN作为绝缘基板, PG作为发热体。在非氧化环境,这种独特的材料组合提供了传统热系统中无法获得的性能优势。

产品特点

- ▶ 高纯度 (>99.999%)
- ▶ 化学惰性
- ▶ 低放气率
- ▶ 高温下热膨胀小
- ▶ 温度均匀性优越
- ▶ 可急速升降温
- ▶ 形状可定制
- ▶ 最高使用温度可达1600°C (真空)



产品应用

溅射镀膜、CVD领域的基板加热

电子显微镜试样加热

气体加热的喷嘴加热器

金属源蒸发加热

主要性能参数

形状	尺寸	厚度/高度 (mm)	电阻 (Ω)
盘形	0.5"-15"	Max 4.0	5-35
筒形	1"-12"	Max 400	3-25

钽金属制品

——钽坩埚, 钽喷嘴, 钽挂件

钽(Tantalum)是一种难熔金属, 密度为16.6 g/cm³, 熔点为2,996 °C, 是仅次于钨、铼的第三个最难熔的金属。钽坩埚、钽喷嘴可作为OLED、MBE、CIGS等高温高真空技术工艺上蒸发源的主要容器和配件使用。

产品特点

- ▶ 纯度高
- ▶ 优异的导热性
- ▶ 热膨胀系数低
- ▶ 易清洗可重复使用
- ▶ 抗酸能力强
- ▶ 抗液态金属腐蚀能力强
- ▶ 高温放气率低

产品应用

耐化学腐蚀容器

金属溅射和蒸发容器

制造高温合金和电子束熔炼

